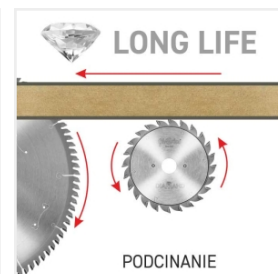
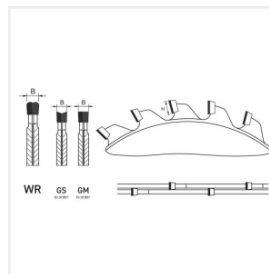


DI316

Podcinaki składane DIA

Promocja



Cechy - korzyści

wysokość płytki z polikryształu diamentu PKD = 6,0 mm - możliwość od 8 do 10 ostrzei
możliwość wykonania podcinaków na indywidualne zamówienie o średnicach zewnętrznych fi 80 mm oraz fi 100 mm i większych
podcinaki DIA to wysokowydajne narzędzia przemysłowe posiadające syntetyczny diament z ziaren o mikronowej wielkości

Zastosowanie

do podcinania wierzchniej warstwy laminatu, okleiny w tworzywach drewnopochodnych (płyta wiórowa laminowana, surowa, MDF, HDF, LDF, etc.)
piła podcinająca współpracująca z piłą główną na formatyzerkach z możliwością regulacji przekładkami dystansowymi
w przemyśle meblarskim stosowane najczęściej do pracy na formatyzerkach poziomych

Katalog	Index	Średnica zewnętrzna (D)	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	Z Ilość zębów	Geometria zęba	H [mm] Wysokość płytki PKD	J.m.
○	DI316-0125-0004	0125	20	2,8-3,6	12+12	WR 5	6	szt.
○	DI316-0125-0003	0125	22	2,8-3,6	12+12	WR 5	6	szt.

Do pobrania

[DaneTech_DI_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

Podcinaki stożkowe DIA



[Piła LL CUT line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)

Piły tarczowe DIA



[Piła LL CUT VH line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)

Podcinaki stożkowe LL CUT VH line 1GR do podcinania tworzyw drewnopochodnych



[Piła LL CUT speedline GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)

Podcinaki składane LL CUT line GS do podcinania tworzyw drewnopochodnych



[Piły LL CUT line GS do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piły LL CUT VH line 3GS do cięcia forniru naturalnego w pakiecie i ramek](#)



[Piły LL CUT VH line GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych w pakiecie](#)



[Piły LL MULTI CUT VH do cięcia pojedynczego i pakietowego tworzyw drewnopochodnych](#)

